

電子回路基板生産動向(2005年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 17年 1月 実績	電子回路基板	1,993	62,446	92.0	89.4	1,993	62,446	92.0	89.4
	リジッドプリント配線板	1,317	38,039	93.1	91.0	1,317	38,039	93.1	91.0
	片面プリント配線板	307	1,543	79.1	81.3	307	1,543	79.1	81.3
	両面プリント配線板	559	10,457	114.3	110.7	559	10,457	114.3	110.7
	多層プリント配線板(4層)	245	7,976	82.9	84.8	245	7,976	82.9	84.8
	多層プリント配線板(6-8層)	94	7,478	89.4	91.8	94	7,478	89.4	91.8
	多層プリント配線板(10層以上)	21	3,182	91.3	85.8	21	3,182	91.3	85.8
	ビルドアップ多層配線板	91	7,403	82.7	84.2	91	7,403	82.7	84.2
	フレキシブルプリント配線板	473	11,507	87.8	90.1	473	11,507	87.8	90.1
	片面フレキシブル配線板	263	5,107	83.0	92.2	263	5,107	83.0	92.2
	両面・多層フレキシブル配線板	209	6,400	91.8	88.4	209	6,400	91.8	88.4
	モジュール基板	200	12,731	98.5	85.3	200	12,731	98.5	85.3
	リジッド系モジュール基板	33	6,483	64.7	72.4	33	6,483	64.7	72.4
その他のモジュール基板	168	6,248	110.5	104.7	168	6,248	110.5	104.7	
その他の電子回路基板	2	169	200.0	213.9	2	169	200.0	213.9	
平成 17年 2月 実績	電子回路基板	2,001	63,261	89.9	91.0	3,995	125,707	90.9	90.2
	リジッドプリント配線板	1,336	39,513	91.2	93.7	2,653	77,552	92.0	92.4
	片面プリント配線板	309	1,543	77.8	79.1	616	3,086	78.5	80.2
	両面プリント配線板	566	10,562	111.6	110.9	1,125	21,019	112.9	110.8
	多層プリント配線板(4層)	243	8,119	80.6	83.9	488	16,095	81.7	84.4
	多層プリント配線板(6-8層)	100	8,018	79.9	96.2	194	15,496	84.2	94.0
	多層プリント配線板(10層以上)	20	3,172	90.9	90.3	41	6,354	91.1	88.0
	ビルドアップ多層配線板	98	8,099	89.9	92.2	189	15,502	86.3	88.2
	フレキシブルプリント配線板	475	11,572	86.8	89.4	947	23,079	87.3	89.7
	片面フレキシブル配線板	259	4,987	80.4	86.2	522	10,094	81.7	89.1
	両面・多層フレキシブル配線板	216	6,585	93.2	92.0	425	12,985	92.5	90.2
	モジュール基板	189	12,004	94.0	85.5	390	24,735	96.3	85.4
	リジッド系モジュール基板	31	6,109	63.3	76.6	64	12,592	64.0	74.4
その他のモジュール基板	158	5,895	103.3	97.2	326	12,143	106.9	100.9	
その他の電子回路基板	2	172	200.0	183.0	4	341	200.0	197.1	
平成 17年 3月 実績	電子回路基板	2,167	70,472	89.5	90.2	6,160	196,179	90.4	90.2
	リジッドプリント配線板	1,427	44,212	88.9	92.3	4,080	121,764	91.0	92.4
	片面プリント配線板	309	1,657	72.5	81.3	926	4,743	76.5	80.6
	両面プリント配線板	595	11,141	104.4	102.9	1,720	32,160	109.9	107.9
	多層プリント配線板(4層)	273	9,255	81.0	83.4	761	25,350	81.5	84.0
	多層プリント配線板(6-8層)	119	9,617	95.9	99.7	313	25,113	88.6	96.1
	多層プリント配線板(10層以上)	23	3,652	100.0	95.5	64	10,006	94.1	90.6
	ビルドアップ多層配線板	107	8,890	87.7	88.6	296	24,392	87.1	88.3
	フレキシブルプリント配線板	514	12,669	87.6	90.5	1,461	35,748	87.3	90.0
	片面フレキシブル配線板	273	5,340	80.1	90.9	795	15,434	81.1	89.7
	両面・多層フレキシブル配線板	241	7,329	94.7	90.2	666	20,314	93.3	90.2
	モジュール基板	224	13,383	103.2	84.6	613	38,118	98.6	85.1
	リジッド系モジュール基板	33	6,596	60.0	67.9	97	19,188	63.0	72.0
その他のモジュール基板	192	6,787	117.8	111.3	517	18,930	110.7	104.4	
その他の電子回路基板	3	208	150.0	129.2	7	549	175.0	164.4	
平成 17年 4月 実績	電子回路基板	2,019	65,420	85.9	91.0	8,181	261,599	89.3	90.4
	リジッドプリント配線板	1,360	40,847	87.0	89.0	5,439	162,611	89.9	91.5
	片面プリント配線板	307	1,614	74.2	80.7	1,233	6,357	75.9	80.6
	両面プリント配線板	571	10,764	101.8	100.3	2,291	42,924	107.8	105.9
	多層プリント配線板(4層)	249	8,633	77.9	86.6	1,010	33,983	80.6	84.6
	多層プリント配線板(6-8層)	107	8,163	85.5	90.6	420	33,276	87.7	94.7
	多層プリント配線板(10層以上)	21	3,613	95.5	94.3	85	13,619	94.4	91.6
	ビルドアップ多層配線板	104	8,060	89.7	81.4	400	32,452	87.7	86.5
	フレキシブルプリント配線板	442	11,447	77.1	85.6	1,903	47,195	84.7	88.9
	片面フレキシブル配線板	233	4,790	68.3	80.8	1,028	20,224	77.8	87.4
	両面・多層フレキシブル配線板	209	6,657	87.5	89.4	875	26,971	91.8	90.0
	モジュール基板	214	12,901	107.0	105.1	828	51,019	100.7	89.4
	リジッド系モジュール基板	31	6,209	91.2	103.7	128	25,397	68.1	77.8
その他のモジュール基板	183	6,692	110.2	106.4	700	25,622	110.6	104.9	
その他の電子回路基板	3	225	100.0	123.0	10	774	142.9	149.7	

電子回路基板生産動向(2005年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 17年 5月 実績	電子回路基板	1,901	62,823	86.1	93.0	10,082	324,422	88.7	90.9
	リジッドプリント配線板	1,273	39,663	88.9	96.6	6,712	202,274	89.7	92.5
	片面プリント配線板	289	1,476	72.3	71.8	1,522	7,833	75.2	78.8
	両面プリント配線板	521	9,831	105.4	102.4	2,812	52,755	107.3	105.2
	多層プリント配線板(4層)	236	8,588	78.3	92.1	1,246	42,571	80.1	86.1
	多層プリント配線板(6-8層)	108	8,745	89.3	101.1	528	42,021	88.1	96.0
	多層プリント配線板(10層以上)	20	3,416	105.3	101.2	105	17,035	96.3	93.3
	ビルドアップ多層配線板	99	7,607	107.6	98.8	499	40,059	91.1	88.6
	フレキシブルプリント配線板	413	10,277	75.0	79.2	2,316	57,472	82.8	87.0
	片面フレキシブル配線板	225	4,212	69.2	75.3	1,253	24,436	76.1	85.1
	両面・多層フレキシブル配線板	188	6,065	80.8	82.1	1,063	33,036	89.7	88.4
	モジュール基板	213	12,717	101.4	97.1	1,041	63,736	100.9	90.9
	リジッド系モジュール基板	32	6,302	100.0	95.2	160	31,699	72.7	80.8
その他のモジュール基板	181	6,415	101.7	99.1	881	32,037	108.6	103.7	
その他の電子回路基板	2	166	100.0	111.4	12	940	133.3	141.1	
平成 17年 6月 実績	電子回路基板	2,075	69,547	88.0	94.1	12,158	393,969	88.6	91.4
	リジッドプリント配線板	1,380	44,334	90.6	100.5	8,093	246,608	89.9	93.8
	片面プリント配線板	306	1,472	70.7	59.2	1,828	9,305	74.4	74.9
	両面プリント配線板	571	11,085	111.1	106.6	3,383	63,840	107.9	105.5
	多層プリント配線板(4層)	260	9,235	81.6	94.5	1,507	51,806	80.4	87.4
	多層プリント配線板(6-8層)	117	9,538	93.5	113.2	644	51,559	88.8	98.7
	多層プリント配線板(10層以上)	24	3,956	104.3	103.6	130	20,991	97.7	95.1
	ビルドアップ多層配線板	102	9,048	97.1	102.7	601	49,107	92.0	90.9
	フレキシブルプリント配線板	449	11,138	74.8	77.7	2,765	68,610	81.4	85.3
	片面フレキシブル配線板	252	4,739	74.1	80.9	1,506	29,175	75.9	84.4
	両面・多層フレキシブル配線板	196	6,399	72.9	75.5	1,259	39,435	86.6	86.1
	モジュール基板	244	13,925	112.4	93.2	1,285	77,661	103.0	91.3
	リジッド系モジュール基板	33	6,503	86.8	77.0	193	38,202	75.1	80.1
その他のモジュール基板	212	7,422	117.8	114.3	1,093	39,459	110.3	105.5	
その他の電子回路基板	2	150	50.0	64.1	14	1,090	107.7	121.1	
平成 17年 7月 実績	電子回路基板	2,087	69,406	88.3	96.2	14,245	463,375	88.5	92.1
	リジッドプリント配線板	1,378	44,038	88.3	98.7	9,471	290,646	89.6	94.5
	片面プリント配線板	283	1,355	63.0	54.1	2,111	10,660	72.6	71.4
	両面プリント配線板	582	11,263	108.3	105.2	3,965	75,103	108.0	105.4
	多層プリント配線板(4層)	270	9,319	86.0	95.8	1,777	61,125	81.2	88.6
	多層プリント配線板(6-8層)	113	9,064	93.4	107.8	757	60,623	89.5	100.0
	多層プリント配線板(10層以上)	23	3,781	92.0	98.2	153	24,772	96.8	95.6
	ビルドアップ多層配線板	107	9,256	100.9	102.9	708	58,363	93.3	92.6
	フレキシブルプリント配線板	453	11,159	77.4	77.8	3,217	79,769	80.8	84.2
	片面フレキシブル配線板	239	4,472	71.6	78.5	1,745	33,647	75.2	83.5
	両面・多層フレキシブル配線板	213	6,687	82.4	77.4	1,472	46,122	85.9	84.7
	モジュール基板	254	14,058	125.1	110.7	1,540	91,719	106.1	93.8
	リジッド系モジュール基板	31	6,467	100.0	101.9	224	44,669	77.8	82.7
その他のモジュール基板	223	7,591	129.7	119.5	1,316	47,050	113.2	107.6	
その他の電子回路基板	2	151	50.0	53.9	16	1,241	94.1	105.2	
平成 17年 8月 実績	電子回路基板	2,056	69,213	95.7	103.3	16,302	532,588	89.4	93.4
	リジッドプリント配線板	1,345	43,579	94.9	107.1	10,817	334,225	90.3	96.0
	片面プリント配線板	261	1,245	72.5	72.2	2,372	11,905	72.6	71.5
	両面プリント配線板	581	11,167	104.3	102.8	4,546	86,270	107.5	105.1
	多層プリント配線板(4層)	262	9,214	92.9	100.5	2,039	70,339	82.6	90.0
	多層プリント配線板(6-8層)	107	8,808	105.9	117.0	864	69,431	91.3	101.9
	多層プリント配線板(10層以上)	21	3,648	105.0	114.2	174	28,420	97.8	97.6
	ビルドアップ多層配線板	114	9,497	118.8	119.7	822	67,860	96.1	95.6
	フレキシブルプリント配線板	445	10,705	83.6	82.0	3,662	90,474	81.1	83.9
	片面フレキシブル配線板	234	4,815	77.2	90.2	1,979	38,462	75.5	84.3
	両面・多層フレキシブル配線板	211	5,890	89.5	76.3	1,683	52,012	86.4	83.6
	モジュール基板	264	14,774	142.7	116.4	1,804	106,493	110.3	96.4
	リジッド系モジュール基板	33	7,008	94.3	99.0	257	51,677	79.6	84.5
その他のモジュール基板	231	7,766	154.0	138.3	1,547	54,816	117.8	111.1	
その他の電子回路基板	2	155	50.0	52.9	18	1,396	85.7	94.8	

電子回路基板生産動向(2005年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比		
	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	
平成 17年 9月 実績	電子回路基板	2,189	74,332	96.7	105.4	18,489	606,920	90.2	94.7
	リジッドプリント配線板	1,435	46,996	94.8	105.3	12,251	381,221	90.8	97.0
	片面プリント配線板	270	1,282	72.4	70.2	2,642	13,187	72.6	71.4
	両面プリント配線板	628	12,179	105.4	104.3	5,175	98,449	107.3	105.0
	多層プリント配線板(4層)	269	9,459	87.9	97.0	2,308	79,798	83.2	90.8
	多層プリント配線板(6-8層)	114	9,396	100.3	105.2	978	78,827	92.2	102.3
	多層プリント配線板(10層以上)	24	3,765	114.3	111.7	198	32,185	99.5	99.1
	ビルドアップ多層配線板	129	10,915	125.2	125.1	951	78,775	99.3	98.9
	フレキシブルプリント配線板	481	11,718	85.3	86.1	4,143	102,192	81.6	84.2
	片面フレキシブル配線板	248	5,181	78.2	93.0	2,228	43,643	75.8	85.3
	両面・多層フレキシブル配線板	233	6,537	91.6	81.3	1,915	58,549	86.9	83.4
	モジュール基板	270	15,355	156.1	130.8	2,073	121,848	114.6	99.7
	リジッド系モジュール基板	33	7,162	100.0	111.5	290	58,839	81.5	87.1
その他のモジュール基板	237	8,193	169.3	154.1	1,783	63,009	122.7	115.2	
その他の電子回路基板	4	263	80.0	77.6	22	1,659	84.6	91.6	
平成 17年 10月 実績	電子回路基板	2,177	74,125	101.6	110.6	20,669	681,045	91.3	96.2
	リジッドプリント配線板	1,443	46,526	98.4	112.0	13,695	427,747	91.5	98.5
	片面プリント配線板	285	1,319	77.7	72.5	2,927	14,506	73.0	71.5
	両面プリント配線板	624	11,570	104.4	101.3	5,799	110,019	106.9	104.6
	多層プリント配線板(4層)	260	9,447	94.9	107.4	2,568	89,245	84.2	92.3
	多層プリント配線板(6-8層)	119	9,588	113.1	122.5	1,097	88,415	94.1	104.1
	多層プリント配線板(10層以上)	22	3,746	95.7	118.0	220	35,931	99.1	100.8
	ビルドアップ多層配線板	133	10,856	135.7	133.0	1,084	89,631	102.7	102.0
	フレキシブルプリント配線板	449	11,477	89.3	88.7	4,593	113,669	82.3	84.6
	片面フレキシブル配線板	220	4,772	82.1	92.6	2,448	48,415	76.3	85.9
	両面・多層フレキシブル配線板	230	6,705	95.0	86.2	2,145	65,254	87.7	83.6
	モジュール基板	281	15,856	172.4	131.7	2,354	137,704	119.4	102.6
	リジッド系モジュール基板	33	7,033	97.1	103.4	323	65,872	82.8	88.6
その他のモジュール基板	248	8,823	192.2	168.3	2,031	71,832	128.4	119.9	
その他の電子回路基板	4	266	100.0	94.7	26	1,925	86.7	92.0	
平成 17年 11月 実績	電子回路基板	2,241	78,110	101.9	113.0	22,912	759,155	92.2	97.7
	リジッドプリント配線板	1,495	49,569	100.8	117.0	15,191	477,316	92.4	100.1
	片面プリント配線板	309	1,403	84.0	81.2	3,236	15,909	74.0	72.2
	両面プリント配線板	636	11,980	108.0	111.2	6,435	121,999	107.0	105.2
	多層プリント配線板(4層)	267	10,030	94.3	105.1	2,835	99,275	85.1	93.4
	多層プリント配線板(6-8層)	125	10,651	108.0	122.0	1,222	99,066	95.4	105.8
	多層プリント配線板(10層以上)	24	4,189	133.3	137.6	244	40,120	101.7	103.7
	ビルドアップ多層配線板	135	11,316	128.6	137.9	1,219	100,947	105.0	105.1
	フレキシブルプリント配線板	455	11,433	87.5	88.1	5,049	125,102	82.8	84.9
	片面フレキシブル配線板	214	4,817	80.8	97.9	2,662	53,232	76.7	86.9
	両面・多層フレキシブル配線板	242	6,616	92.1	82.2	2,387	71,870	88.2	83.5
	モジュール基板	288	16,886	155.7	127.1	2,642	154,590	122.5	104.8
	リジッド系モジュール基板	38	8,045	105.6	108.3	361	73,917	84.7	90.4
その他のモジュール基板	250	8,841	168.9	151.0	2,281	80,673	131.8	122.7	
その他の電子回路基板	3	222	100.0	91.7	29	2,147	87.9	91.9	
平成 17年 12月 実績	電子回路基板	2,028	74,284	97.5	114.7	24,935	834,330	92.6	99.1
	リジッドプリント配線板	1,336	46,581	98.6	115.9	16,523	524,720	92.8	101.5
	片面プリント配線板	251	1,264	77.5	77.2	3,444	17,169	73.3	72.5
	両面プリント配線板	572	11,330	101.4	104.5	7,021	133,553	106.8	105.3
	多層プリント配線板(4層)	263	9,477	100.2	110.8	3,106	108,952	86.4	94.9
	多層プリント配線板(6-8層)	111	9,854	119.9	125.6	1,333	108,920	97.1	107.3
	多層プリント配線板(10層以上)	23	4,209	121.1	129.0	267	44,329	103.1	105.6
	ビルドアップ多層配線板	117	10,447	127.2	135.1	1,353	111,797	107.9	107.7
	フレキシブルプリント配線板	422	10,994	80.4	87.3	5,473	136,172	82.6	85.2
	片面フレキシブル配線板	216	4,924	78.0	93.2	2,878	58,182	76.8	87.4
	両面・多層フレキシブル配線板	205	6,070	80.3	83.1	2,595	77,990	87.5	83.5
	モジュール基板	268	16,549	144.1	143.5	2,908	171,131	124.1	107.6
	リジッド系モジュール基板	37	8,019	127.6	146.7	398	81,936	87.5	93.9
その他のモジュール基板	230	8,530	146.5	140.5	2,510	89,195	132.9	124.2	
その他の電子回路基板	2	160	66.7	64.0	30	2,307	83.3	89.2	

電子回路基板生産動向(2005年)

	当月実績		前年同月比		累 計		前年同期間比	
	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)	数量 (千m2)	生産額 (百万円)	数量 (%)	生産額 (%)

接続係数について

平成16年12月以前の数値を使用して前年同月比を求める場合、下記の係数で前年同月比を乗じて計算して下さい

	数 量	金 額
電子回路基板	1.045	1.028
リジッドプリント配線板	1.062	1.040
両面プリント配線板	1.077	1.054
多層プリント配線板(4層)	1.146	1.085
多層プリント配線板(6~8層)	1.052	
フレキシブルプリント配線板		
両面・多層フレキシブル配線板	1.030	

(出所：経済産業省「機械統計月報」)

(2006/4/17 修正値発表 / 2006/4/20 JPCA作成)